

用于SiC Wafer高性能研磨浆料

# NANOBIK™

## 用途

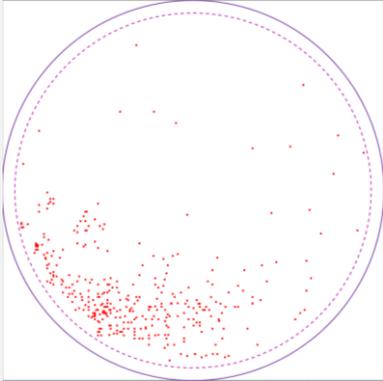
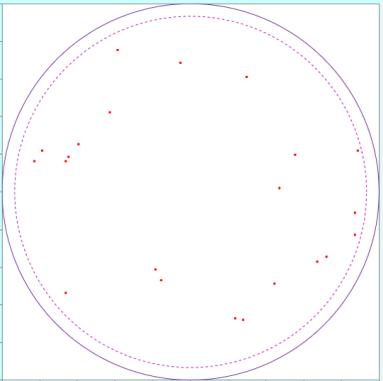
- 用于SiC Wafer抛光、双组分混合型抛光液

## 概要・特徴

- 通过MnO<sub>2</sub>磨粒，可以在一次抛光中实现高速且低损伤的加工。
- 可抑制C面和Si面的研磨速率差
- 抛光设备的清洗/SiC Wafer容易清洗
- 可循环使用



A液 B液

	市售的外延准备片	CMP后
Mapping of sub surface damage detected		
Density of sub surface damage	158(/cm <sup>2</sup> )	10(/cm <sup>2</sup> )

※过电子扫描显微镜进行的潜伤评估结果  
(Mirelis VM1000 by Hitachi High-Tech Co.)